

編 集 後 記

今号では物質中の量子化伝導やスピン流に対する表面（界面）効果が実験的に観測された記事が掲載されています。私自身の専門分野である表面科学とも関係が深く、今後の研究展開がとても楽しみです。一方、受賞記事では若手の活躍に感心させられ、物性若手夏の学校開催報告では彼らのやる気も伝わってきました。物性科学の将来もどうやら期待できそうです。

「物性研だより」最新号発刊の連絡を電子メールでも発信することになりました。共同研究者や卒業生など、ご希望の方は以下にご連絡ください。

松 田 巖

<連絡先>

国立大学法人東京大学物性研究所共同利用係
〒277-8581 千葉県柏市柏の葉五丁目1番5号
E-mail: issp-kyodo@issp.u-tokyo.ac.jp